

簡単に高精度ウェハカットを。 ハンドスクライバー



特長

- カット時のウェハ滑りを抑制
- カット位置の視認性向上
- 正確なカットポイントをセッティング
- 最適な刃先角度の設定と保持が可能
- ウェハへの荷重を一定にコントロール
- 直線ラインが思い通りに

使用方法

1 ツールを組立てます

2 プレートにウェハを挟みます

ウェハなど

3 ガイドに沿ってカットするだけ

より詳しい使用方法は
下記QRコードから
(動画再生時間約1分)

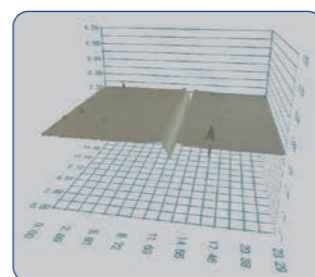
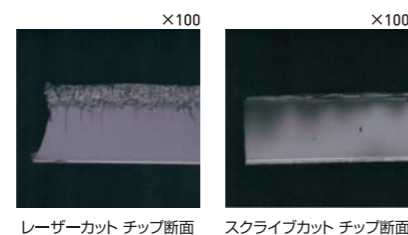
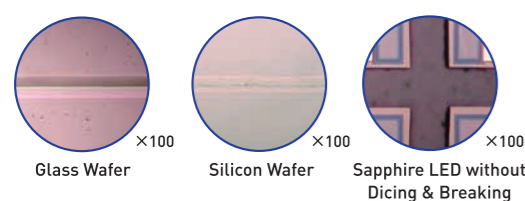
TECDIA's Diamond Scribing Tool



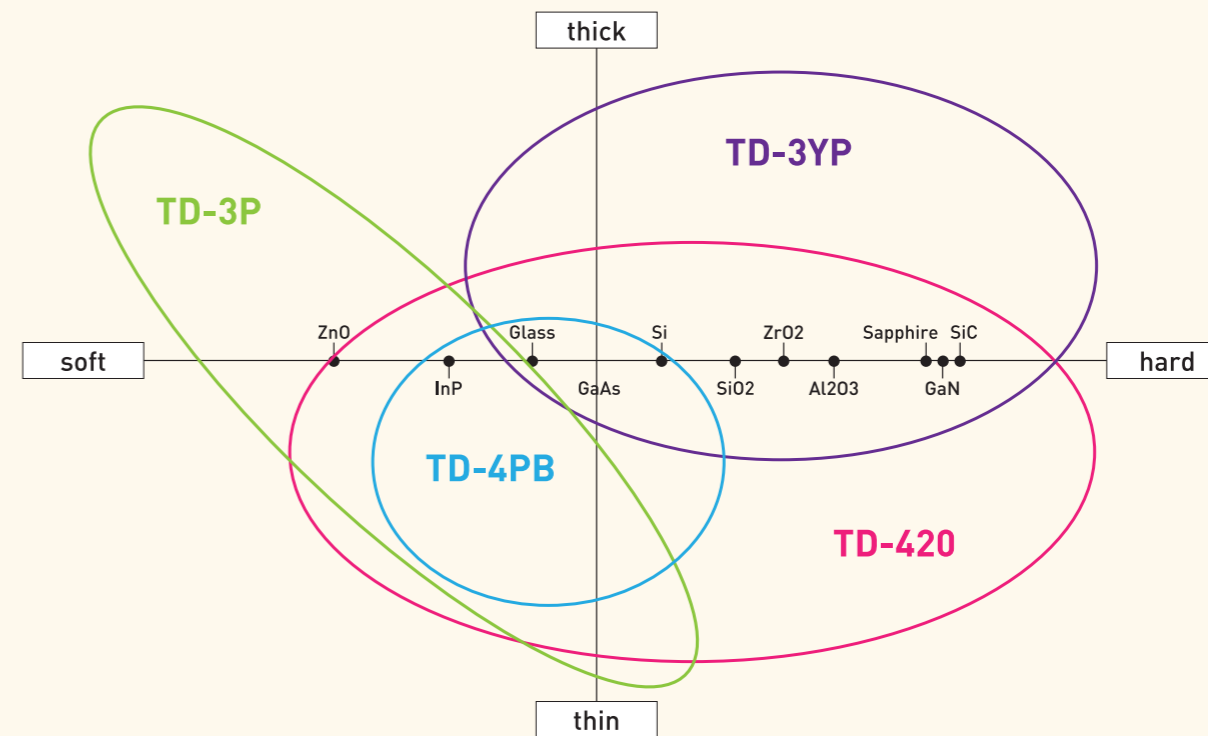
スクライブ・スペシャリスト=テクダイヤの製品をトライしてみませんか。

スクライブカットの特徴

- 1 ドライカット**
カット作業中に水を用いないため、水溶性の素材や静電気他、水が原因でのチップへの悪影響がありません。
- 2 チップ集積率向上**
一般的に、スクライブのカット幅は2~5μであるため、ウェハ当りのチップ集積率が上がり、コストダウンを計画できます。
- 3 クラックコントロール**
スクライブカットは、スクライブで発生する内部応力を用い、そこから起きるクラックで、チップを希望通りの形状にカットすることです。このクラックを上手にコントロールするためには、ウェハに最適な刃先形状を選択する必要があります。

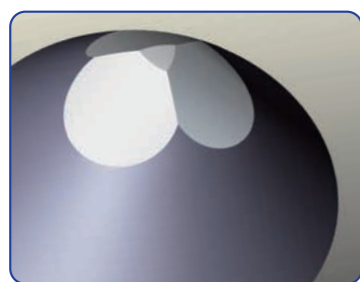


ツール・セレクション



*その他TD-2P、TD-8Pはカスタム仕様でお作りします。
*この表以外にも、ウェハ表面加工(エッチング有無、保護膜の材質他)、またチップサイズ(アスペクト比)など様々な状況により最適なツールが変わります。

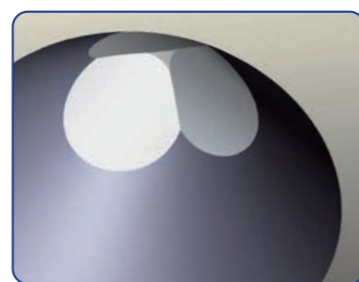
テクダイヤ製 ダイヤモンド・スクライブツール



TD-3YP

SiC、サファイアウェハ用ツール

先端に3つのカットポイントを持つツールです。ウェハカット時の刃先接地角は鈍角で、硬く厚いウェハカットに適しています。主に、サファイアウェハに向いています。



TD-3P

半導体ウェハ用(InP他)ツール

先端に3つのカットポイントを持つツールです。TD-3YPに比べ鋭角な刃先を持ち、硬いウェハにシャープなカットラインを作るときに適しています。



TD-4PB

半導体ウェハ用(Si他)ツール(トゥカット)

先端に4つのカットポイントを持つツールです。刃先はダイヤモンドの一番硬い部分で形成され、GaAs、LCOS、Glass、Siなどの半導体ウェハ全般に適しています。



TD-420

半導体ウェハ用(GaAs他)・ガラス用ツール(ヒールカット)

先端に4つのカットポイントを持つツールで、ウェハカット時の刃先接地面はTD-4PBと逆の三角形になります。そのカットはTD-4PBに比べ、より細く深いカットラインと強い内部応力を生みます。*ヒール角度カスタム製作可能

カスタム品

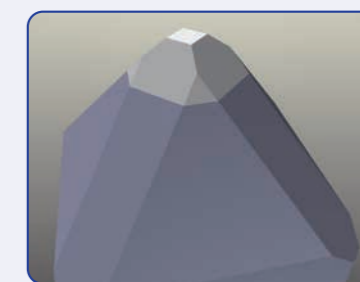
*仕様については、ご相談ください。



TD-2P

半導体ウェハ用ツール(トゥカット)

TD-4PBと同等の特徴を持ちながら、刃先を2ポイントにしたツールです。メサ型、ハイブリッドタイプウェハ等、より狭く深いカットストリートへの接地が容易になります。チップ上面とストリートとの高低差が大きいウェハでの使用に適しています。



TD-8P

スクライブ条件抽出・開発用ツール(トゥ・ヒールカット)

TD-4PBとTD-420両方の刃先をそろえ、合計8ポイントのカットポイントを持つツールです。適切な刃先、スクライブ角度など、スクライブ条件の抽出・開発に適しています。